

# ご挨拶

## - ダイナミックコラボレーション関連特集によせて -

NEC 技報編集委員長 北澤 進

読者各位におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

すでに昨年末発行の第12号のなかでご案内させていただきましたとおり、NEC技報は本年発行分より、隔月刊とさせていただきます。

NECはここ数年来、経営構造改革を推進し、コア事業を「ITとネットワークの統合ソリューション」と「半導体ソリューション」と位置付け、事業の選択と集中を行ってまいりました。こうしたなかで半導体事業につきましてはビジネスモデルが異なるため、NECエレクトロニクスを設立、分社いたしましたことから、技術広報においても独自の活動をめざすことになりました。したがって、今後NEC技報は、NEC本体のコア技術である「ソリューション」や「ネットワーク」、「ソフトウェア」、「サービス」といった分野の技術・製品を中心に、皆様にご紹介していくこととなります。分野によっては技術論文形式での紹介に馴染みにくい面がありますが、技術的内容を皆様に分かりやすく、興味を引かれるよう工夫してお伝えしていきたいと考えておりますので、引き続きご愛読をお願い申し上げます。

本号最初の特集では、まずNECが皆様に提案する新しい企業連携の在り方・考え方、「ダイナミックコラボレーション」についてご紹介し、続いてそれを実現するために現在NECが開発に取り組んでいる先進技術・製品のご紹介をさせていただきます。次の特集は、昨年10月に行われたITU（国際電気通信連合）主催の展示会「TELECOM WORLD 2003」からのご報告であり、ダイナミックコラボレーションを支える基盤技術・製品を世界のお客様に訴える目的で出展させていただいたものです。開催地スイス・ジュネーブの会場の雰囲気も併せて感得していただければ誠に幸いです。